

(C)

9705171-8

15/01/98

RTMP
COPY



PCT
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶: C08G 18/00, 18/16, 59/62		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 96/37532
			(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 28. November 1996 (28.11.96)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE96/00808		(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, KR, <u>SG</u> , US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).	
(22) Internationales Anmeldedatum: 9. Mai 1996 (09.05.96)			
(30) Prioritätsdaten: 195 19 239.7 24. Mai 1995 (24.05.95) DE		Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht.	
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).			
(72) Erfinder; und			
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): VON GENTZKOW, Wolfgang [DE/DE]; Zwetschgenweg 1, D-91077 Kleinsendelbach (DE). KRETZSCHMAR, Klaus [DE/DE]; Im Heuschlag 5, D-91054 Erlangen (DE). SCHREYER, Michael [DE/DE]; Holderweg 13, D-91085 Weisendorf (DE). DONNER, Peter [DE/DE]; Gartenweg 17, D-91334 Hemhofen (DE).			
(54) Title: EPOXY RESIN MOULDING MATERIALS FIRE-PROOFED WITHOUT HALOGENS			
(54) Bezeichnung: EPOXIDHARZFORMMASSEN MIT HALOGENFREIEM FLAMMSCHUTZ			
(57) Abstract Pourable, fire-proofed, latently reactive, phenol setting epoxy resin moulding materials used to envelop electronic components contain the following elements: an epoxy resin produced from a solvent-free reaction mixture of polyepoxy resin and polyisocyanate resin with a molar ratio between epoxy and isocyanate groups from 1.1 to 4 at a reaction temperature of up to 220 °C in the presence of a concentration of reaction accelerator from 0.5 to 2.5 % and of triphenylphosphine oxide from 0.05 to 10 %, both times in relation to the resin reaction mixture; a setting agent with at least two phenolic hydroxyl groups per molecule; an inorganic filler and usual additives.			
(57) Zusammenfassung Flammwidrig eingestellte, rieselfähige, latent reaktive, phenolisch härtbare Epoxidharzformmassen zur Umhüllung von elektronischen Bauelementen enthalten folgende Komponenten: eine Epoxidharzkomponente, erhalten aus einer lösungsmittelfreien Reaktionsharzmischung von Polyepoxidharz und Polyisocyanatharz mit einem Molverhältnis der Epoxidgruppen zu den Isocyanatgruppen von 1,1 bis 4 bei einer Reaktionstemperatur bis zu 220 °C in Gegenwart eines Reaktionsbeschleunigers in einer Konzentration von 0,5 bis 2,5 % und unter Verwendung von Triphenylphosphinoxid in einer Konzentration von 0,05 bis 10 %, jeweils bezogen auf die Reaktionsharzmischung; eine Härterkomponente mit mindestens zwei phenolischen Hydroxylgruppen pro Molekül; anorganischen Füllstoff; und übliche Zusatzstoffe.			

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
AT	Österreich	GE	Georgien	NE	Niger
AU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbados	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungarn	NZ	Neuseeland
BF	Burkina Faso	IE	Irland	PL	Polen
BG	Bulgarien	IT	Italien	PT	Portugal
BJ	Benin	JP	Japan	RO	Rumänien
BR	Brasilien	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
BY	Belarus	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SG	Singapur
CG	Kongo	KZ	Kasachstan	SI	Slowenien
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	SK	Slowakei
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SN	Senegal
CM	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China	LK	Litauen	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
EE	Estland	MG	Madagaskar	UG	Uganda
ES	Spanien	ML	Mali	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	MN	Mongolei	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MR	Mauretanien	VN	Vietnam
GA	Gabon	MW	Malawi		